公司代码:688173 公司简称:希荻微

# 广东希荻微电子股份有限公司

# 【2022】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

因公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为负,且充分考虑到公司目前处于快速发展期,经营规模不断扩大,资金需求较大,为更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定的2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积转增股本。公司2022年度利润分配方案已经公司第一届董事会第三十六次和第一届监事会第二十五会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 希荻微 | 688173 | 无 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 唐娅 | 周紫慧 |
| 办公地址 | 佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元(住所申报) | 佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元(住所申报) |
| 电话 | 0757-81280550 | 0757-81280550 |
| 电子信箱 | ir@halomicro.com | ir@halomicro.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务,主要产品或服务情况

1.公司的主要业务

公司是国内领先的半导体和集成电路设计企业之一,主营业务为包括电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路的研发、设计和销售。公司主要产品为服务于消费类电子和车载电子领域的电源管理芯片及信号链芯片等模拟集成电路,现有产品布局覆盖DC/DC芯片、锂电池充电管理芯片、端口保护和信号切换芯片、电源转换芯片等,具备高效率、高精度、高可靠性的良好性能。此外,公司计划拓展AF/OIS技术相关的音圈马达驱动芯片作为新的产品线。截至2022年12月末,公司主要的产品布局如下图所示:

未来,公司将在现有消费电子为主的应用领域的基础上,以满足AEC-Q100标准的产品为基础,积极布局汽车电子领域,发力通信及存储等领域,培养与国际龙头厂商相竞争的技术实力。

(二) 主要经营模式

公司采用Fabless经营模式,专注于包括电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路的研发、设计和销售环节,将晶圆制造及封装测试环节委托给相应的代工厂完成。具体而言,公司在芯片产品的研发完成后,将研发成果固集成电路产品布图交付给专业的晶圆代工厂和封测厂,分别委托其进行晶圆制造和封装测试,再将芯片成品直接或通过经销商销售给下游客户。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处行业属于集成电路行业。中国集成电路产业虽起步较晚,但凭借巨大的市场需求、经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件,已成为全球集成电路行业增长的主要驱动力。近年来,随着消费电子、移动互联网、汽车电子、工业控制、医疗电子等市场需求的不断提升,以及国家支持政策的不断提出,中国集成电路行业发展快速。根据Frost&Sullivan预计,未来五年中国集成电路行业将以16.7%的年复合增长率增长,至2025年市场规模将达到18,931.9亿元。

集成电路产业链主要由“设计—制造—封装测试”三个环节构成,集成电路产业是以技术作为核心驱动因素的产业,在设计环节上技术与资本高度密集,是带动整体产业发展的核心因素,也同样是经济附加值最高的环节。集成电路产品根据功能主要可分为数字芯片和模拟芯片,其中数字芯片指基于数字逻辑设计和运行的,用于处理数字信号的集成电路芯片,包括微元件、存储器和逻辑芯片;模拟芯片指处理连续性模拟信号的集成电路芯片,包括电源管理芯片和模拟信号处理芯片。

模拟芯片因其使用周期长的特性,市场增速表现与数字芯片略有不同,市场规模呈现稳步扩张的态势。模拟IC市场空间大,据WSTS数据,2021年全球模拟IC市场规模约为741.05亿美元,占集成电路的16.01%,是半导体中拥有广阔天花板的好赛道。且从成长增速看,WSTS预估2022年,2023年模拟IC市场增速分别为20.85%,1.56%。

根据Frost & Sullivan统计,中国模拟芯片市场规模在全球范围占比达50%以上,为全球最主要的模拟芯片消费市场,且增速高于全球模拟芯片市场整体增速。2021年中国模拟芯片行业市场规模约2,731.4亿元。随着新技术和产业政策的双轮驱动,未来中国模拟芯片市场将迎来发展机遇,预计到2025年中国模拟芯片市场将增长至3,339.5亿元,年复合增长率约5.9%。

欧美等国际领先厂商在集成电路设计领域具有大量的技术积累和完善的产业链配套环境,同时在产销规模、品牌声誉等方面具备领先优势。在政策扶持和中美贸易摩擦的大背景下,中国集成电路产品的品质和市场认可度日渐提升,部分本土电源管理芯片设计企业在激烈的市场竞争中逐渐崛起,整体技术水平和国外设计公司的差距不断缩小,国内企业设计开发的电源管理芯片产品在多个应用市场领域逐渐取代国外竞争对手的份额。

模拟芯片产品性能主要由特色工艺能力、研发设计能力和质量管控能力决定;同时由于其设计工具自动化程度较低,设计难度较大,研发周期较长等特点,该行业高度依赖于工程师的设计能力和设计经验。优秀的模拟芯片设计企业需要长期经验和技术的累积,领先企业依靠丰富的技术及经验、大量的核心IP和产品类别形成竞争壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内领先的电源管理及信号链芯片供应商之一,拥有具备国际化背景的行业高端研发及管理团队,开发出了一系列具有高效率、高精度、高可靠性等良好性能的芯片产品。公司以 DC/DC芯片、超级快充芯片等为代表的主要产品,具备了与国内外龙头厂商相竞争的性能。报告期内,公司与现有主要客户合作稳定,国际国内品牌持续拓展且合作逐渐深入,同时持续丰富产品类型,带动公司营业收入增长。

在手机等消费电子领域,公司产品得到了高通(Qualcomm)、联发科(MTK)等主芯片平台厂商的认可,已广泛应用于三星、小米、荣耀、OPPO、vivo、传音、TCL、谷歌、罗技等品牌客户的消费电子设备中,覆盖包括中高端旗舰机型在内的多款移动智能终端设备。

报告期内,公司持续发力车载电子领域。根据半导体行业研究机构Yole Development的调研报告估算,随着汽车CASE潮流(即指“Connectivity”(联网)、“Autonomous”(自动化)、“Sharing”(分享)以及 “Electrification”(电动化)),单车芯片价值将会在2026年达到700美元。而在模拟芯片领域,IC Insights报告指出汽车用模拟芯片市场规模在2022年预计为137.7亿美元。随着汽车行业智能化、电气化浪潮,单部汽车摄像头、激光雷达、电控系统等新需求也为模拟芯片企业提供了更多的模拟芯片应用场景。根据高盛预估,在2025年,全球汽车销量将达到1.2亿部。脱此估算,车规级模拟芯片是一个超百亿美元市场规模且有巨大增长空间的广阔市场。车载电子领域是公司重点布局的产品应用领域之一。公司的车规芯片布局开始于高通820车规娱乐平台,于2018年开始正式通过YuraTech向韩国现代、起亚车型规模出货车规级DC/DC芯片,随后于2021年正式向德国奥迪供货。现在,公司车规业务已经拓展至中国日韩等多国汽车品牌。产品进展方面,公司借助其在消费类电子领域积累的技术与经验以及招募的汽车产品开发团队的专业知识,聚焦自动驾驶(ADAS),汽车中控和娱乐平台、车身电子以及电动汽车带来的新应用场景等领域,致力于提供满足车规要求的DC/DC、LDO、高频开关、端口保护产品。截至报告期末,研发投入已有十余款按照AEC-Q100 Grade 1标准要求开发的产品处于在研发或定义状态。

此外,公司还通过与业界领先的公司合作,扩充公司的产品线,扩大商业版图。2022年12月,香港希荻微与韩国动运签署了《自动对焦和光学防抖技术许可协议》,获得韩国动运自动对焦(Auto Focus)及光学影像防抖(Optical Image Stabilization)的相关专利及技术在大中华地区的独占使用权。本次交易的标的技术为自动对焦和光学影像防抖技术是应用于摄像头模组的核心技术之一,在智能手机、笔记本电脑、物联网、医疗、汽车电子、安防、工业等领域具有广泛的应用,未来潜在市场空间宽广。本次交易将有助于公司快速切入音圈马达驱动芯片的细分领域,丰富产品类别,加深现有客户的合作维度并开拓新的客户。

希荻微将借助积累的技术优势、客户基础、拓展产品丰富度,对现有产品进一步升级,横向拓展公司产品应用领域,提高公司整体竞争实力。具体体现为完成在电源管理、端口保护和信号切换等细分领域的芯片产品布局,并有序拓展电源转换产品等领域。同时,公司将拓展AF/OIS技术相关的音圈马达驱动芯片产品线,与现有电源管理及信号链芯片产品形成合力,巩固在消费电子领域的行业地位。此外,公司将在现有消费电子及汽车电子应用领域的基础上,以满足AEC-Q100标准的产品为基础,积极布局汽车电子领域,发力通信及存储等领域,不断建立新的收入增长点。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

模拟集成电路产业将会朝着高效低耗化、集成化以及智能化的趋势发展。从产业发展和业态来看,电源管理芯片会由消费电子向高性能领域升级。电源管理芯片应用领域呈现出从消费电子向工业、汽车等高性能领域转型的现象。目前电源管理芯片最大的终端市场仍然是手机和消费类电子产品,但由于该市场竞争不断加剧,盈利空间被压缩;而另一方面,汽车电子、可穿戴设备、智能家电、工业应用、基站和设备等下游需求不断增长,未来随着人工智能、大数据、物联网等新产业的发展,全球需要的电子设备数量及种类迅速增长,在汽车和工业电源IC市场应用领域,由于其应用技术要求较高、相应的产品毛利率较高。整体来看,未来电源管理芯片应用领域从低端消费电子市场向高端工业、汽车市场转型将成为行业发展的新趋势。

希荻微将借助积累的技术优势、客户基础、拓展产品丰富度,对现有产品进一步升级,横向拓展公司产品应用领域,提高公司整体竞争实力。具体体现为完成在电源管理、端口保护和信号切换等细分领域的芯片产品布局,并有序拓展电源转换产品等领域。同时,公司将拓展AF/OIS技术相关的音圈马达驱动芯片产品线,与现有电源管理及信号链芯片产品形成合力,巩固在消费电子领域的行业地位。此外,公司将在现有消费电子及汽车电子应用领域的基础上,以满足AEC-Q100标准的产品为基础,积极布局汽车电子领域,发力通信及存储等领域,不断建立新的收入增长点。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

模拟集成电路产业将会朝着高效低耗化、集成化以及智能化的趋势发展。从产业发展和业态来看,电源管理芯片会由消费电子向高性能领域升级。电源管理芯片应用领域呈现出从消费电子向工业、汽车等高性能领域转型的现象。目前电源管理芯片最大的终端市场仍然是手机和消费类电子产品,但由于该市场竞争不断加剧,盈利空间被压缩;而另一方面,汽车电子、可穿戴设备、智能家电、工业应用、基站和设备等下游需求不断增长,未来随着人工智能、大数据、物联网等新产业的发展,全球需要的电子设备数量及种类迅速增长,在汽车和工业电源IC市场应用领域,由于其应用技术要求较高、相应的产品毛利率较高。整体来看,未来电源管理芯片应用领域从低端消费电子市场向高端工业、汽车市场转型将成为行业发展的新趋势。

希荻微将借助积累的技术优势、客户基础、拓展产品丰富度,对现有产品进一步升级,横向拓展公司产品应用领域,提高公司整体竞争实力。具体体现为完成在电源管理、端口保护和信号切换等细分领域的芯片产品布局,并有序拓展电源转换产品等领域。同时,公司将拓展AF/OIS技术相关的音圈马达驱动芯片产品线,与现有电源管理及信号链芯片产品形成合力,巩固在消费电子领域的行业地位。此外,公司将在现有消费电子及汽车电子应用领域的基础上,以满足AEC-Q100标准的产品为基础,积极布局汽车电子领域,发力通信及存储等领域,不断建立新的收入增长点。

3 报告期公司主要业务或产品发展情况

公司是国内领先的电源管理及信号链芯片供应商之一,拥有具备国际化背景的行业高端研发及管理团队,开发出了一系列具有高效率、高精度、高可靠性等良好性能的芯片产品。公司以 DC/DC芯片、超级快充芯片等为代表的主要产品,具备了与国内外龙头厂商相竞争的性能。报告期内,公司与现有主要客户合作稳定,国际国内品牌持续拓展且合作逐渐深入,同时持续丰富产品类型,带动公司营业收入增长。

在手机等消费电子领域,公司产品得到了高通(Qualcomm)、联发科(MTK)等主芯片平台厂商的认可,已广泛应用于三星、小米、荣耀、OPPO、vivo、传音、TCL、谷歌、罗技等品牌客户的消费电子设备中,覆盖包括中高端旗舰机型在内的多款移动智能终端设备。

报告期内,公司持续发力车载电子领域。根据半导体行业研究机构Yole Development的调研报告估算,随着汽车CASE潮流(即指“Connectivity”(联网)、“Autonomous”(自动化)、“Sharing”(分享)以及 “Electrification”(电动化)),单车芯片价值将会在2026年达到700美元。而在模拟芯片领域,IC Insights报告指出汽车用模拟芯片市场规模在2022年预计为137.7亿美元。随着汽车行业智能化、电气化浪潮,单部汽车摄像头、激光雷达、电控系统等新需求也为模拟芯片企业提供了更多的模拟芯片应用场景。根据高盛预估,在2025年,全球汽车销量将达到1.2亿部。脱此估算,车规级模拟芯片是一个超百亿美元市场规模且有巨大增长空间的广阔市场。车载电子领域是公司重点布局的产品应用领域之一。公司的车规芯片布局开始于高通820车规娱乐平台,于2018年开始正式通过YuraTech向韩国现代、起亚车型规模出货车规级DC/DC芯片,随后于2021年正式向德国奥迪供货。现在,公司车规业务已经拓展至中国日韩等多国汽车品牌。产品进展方面,公司借助其在消费类电子领域积累的技术与经验以及招募的汽车产品开发团队的专业知识,聚焦自动驾驶(ADAS),汽车中控和娱乐平台、车身电子以及电动汽车带来的新应用场景等领域,致力于提供满足车规要求的DC/DC、LDO、高频开关、端口保护产品。截至报告期末,研发投入已有十余款按照AEC-Q100 Grade 1标准要求开发的产品处于在研发或定义状态。

此外,公司还通过与业界领先的公司合作,扩充公司的产品线,扩大商业版图。2022年12月,香港希荻微与韩国动运签署了《自动对焦和光学防抖技术许可协议》,获得韩国动运自动对焦(Auto Focus)及光学影像防抖(Optical Image Stabilization)的相关专利及技术在大中华地区的独占使用权。本次交易的标的技术为自动对焦和光学影像防抖技术是应用于摄像头模组的核心技术之一,在智能手机、笔记本电脑、物联网、医疗、汽车电子、安防、工业等领域具有广泛的应用,未来潜在市场空间宽广。本次交易将有助于公司快速切入音圈马达驱动芯片的细分领域,丰富产品类别,加深现有客户的合作维度并开拓新的客户。

希荻微将借助积累的技术优势、客户基础、拓展产品丰富度,对现有产品进一步升级,横向拓展公司产品应用领域,提高公司整体竞争实力。具体体现为完成在电源管理、端口保护和信号切换等细分领域的芯片产品布局,并有序拓展电源转换产品等领域。同时,公司将拓展AF/OIS技术相关的音圈马达驱动芯片产品线,与现有电源管理及信号链芯片产品形成合力,巩固在消费电子领域的行业地位。此外,公司将在现有消费电子及汽车电子应用领域的基础上,以满足AEC-Q100标准的产品为基础,积极布局汽车电子领域,发力通信及存储等领域,不断建立新的收入增长点。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

模拟集成电路产业将会朝着高效低耗化、集成化以及智能化的趋势发展。从产业发展和业态来看,电源管理芯片会由消费电子向高性能领域升级。电源管理芯片应用领域呈现出从消费电子向工业、汽车等高性能领域转型的现象。目前电源管理芯片最大的终端市场仍然是手机和消费类电子产品,但由于该市场竞争不断加剧,盈利空间被压缩;而另一方面,汽车电子、可穿戴设备、智能家电、工业应用、基站和设备等下游需求不断增长,未来随着人工智能、大数据、物联网等新产业的发展,全球需要的电子设备数量及种类迅速增长,在汽车和工业电源IC市场应用领域,由于其应用技术要求较高、相应的产品毛利率较高。整体来看,未来电源管理芯片应用领域从低端消费电子市场向高端工业、汽车市场转型将成为行业发展的新趋势。

希荻微将借助积累的技术优势、客户基础、拓展产品丰富度,对现有产品进一步升级,横向拓展公司产品应用领域,提高公司整体竞争实力。具体体现为完成在电源管理、端口保护和信号切换等细分领域的芯片产品布局,并有序拓展电源转换产品等领域。同时,公司将拓展AF/OIS技术相关的音圈马达驱动芯片产品线,与现有电源管理及信号链芯片产品形成合力,巩固在消费电子领域的行业地位。此外,公司将在现有消费电子及汽车电子应用领域的基础上,以满足AEC-Q100标准的产品为基础,积极布局汽车电子领域,发力通信及存储等领域,不断建立新的收入增长点。

4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入559,478,983.55元,实现归属于母公司所有者的净亏损15,152,490.28元。截至2022年12月31日,公司总资产为1,946,566,786.65元,归属母公司所有者的净资产为1,793,869,782.28元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2023-022

## 广东希荻微电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为更加真实、准确地反映广东希荻微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“希荻微”)资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对2022年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下:

九、资产减值准备的计提概况

根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策,公司对2022年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试,并根据识别和测试的结果,计提了相关的资产的减值准备。公司2022年对各项资产计提减值准备合计为1,367.12万元,具体情况如下表。

单位:万元

| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|
| 信用减值损失 | -4.01 | -11.70 |
| 其中:应收账款坏账损失 | -4.18 | -20.05 |
| 其他应收款坏账损失 | 0.58 | 7.87 |
| 其他非流动资产坏账损失 | -0.41 | 0.49 |
| 资产减值损失 | 1,371.13 | 133.14 |
| 其中:存货跌价损失 | 1,371.13 | 133.14 |
| 合计 | 1,367.12 | 121.44 |

一、资产减值准备计提的具体情况说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备;除上述应收账款外,于每个资产负债表日,本集团对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司的存货按成本与可变现净值孰低计量。可变现净值指日常活动中,以存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。

受全球宏观经济衰退等国内外多重因素影响,以智能手机、PC 为代表的消费电子市场在本年度持续低迷,消费电子产品需求持续下滑,导致公司库存水平提高;同时,由于芯片供需从 2021 年的供需失紧紧张到 2022 年恢复正常水平,导致公司部分产品销售价格回落。经过评估,公司部分存货的可变现净值出现低于其成本情况。出于谨慎角度考虑,公司基于目前可获取信息,对存在减值迹象的存货计提了存货跌价准备。

一一、计提资产减值准备对公司的影响

公司2022年度计提资产减值准备合计1,367.12万元,导致公司2022年度合并利润总额减少1,367.12万元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会影响公司正常经营。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东希荻微电子股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2023-023

## 广东希荻微电子股份有限公司 关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●广东希荻微电子股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

●公司2022年度利润分配方案已经公司第一届董事会第三十六次会议和第一届监事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一二、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为-15,152,490.28元,截至2022年12月31日,母公司期末可供分配利润为16,663,365.24元。经董事会决议,因公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为负,且充分考虑到公司目前处于快速发展期,经营规模不断扩大,资金需求较大,为更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定的2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案经董事会审议通过后,尚需提交2022年年度股东大会审议。

一三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月19日召开的第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》,同意公司2022年度不进行利润分配并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

根据公司拟定的提交公司董事会审议的《关于2022年度利润分配方案的议案》,结合公司目前的经营情况及未来发展战略,我们认为:董事会提出的2022年度拟不进行利润分配的方案,符合公司实际情况,符合《公司章程》《广东希荻微电子股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》中利润分配条件的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形,有利于保证公司的正常经营和可持续发展。因此,我们一致同意该议案,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年4月19日召开的第一届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。经审核,监事会认为:公司 2022年度实现属于母公司所有者的净利润为负,同意公司2022年度不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积转增股本。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

一四、相关风险提示

公司2022年度利润分配方案符合公司的实际经营情况,不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司2022年年度股东大会审议,并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东希荻微电子股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2023-026

## 广东希荻微电子股份有限公司 关于变更公司名称、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东希荻微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第一届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于变更公司名称、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下:

一五、变更公司名称情况

随着公司规模的不断扩大,公司业务已不仅局限于广东,已经逐步拓展到全国以及海外国家和地区。为了更好地体现公司业务地域发展的实际情况,同时保持公司商号与证券简称的统一性,增强公司在所属行业中的辨识度,公司拟将公司名称由“广东希荻微电子股份有限公司”变更为“希荻微电子集团股份有限公司”。公司股票简称及公司股票代码保持不变。

一六、公司注册资本变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日出具的《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3934号),公司获准向社会公开发行人民币普通股40,010,000股,并于2022年1月21日在上海证券交易所科创板上市。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了核验,并于2022年1月17日出具了普华永道中天验字(2022)第0095号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》。公司首次公开发行股票完成后,公司注册资本由36,000,000万元变更为40,001.00万元,公司股份总数由36,000,00万股变更为40,001.00万股,公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”。

2022年3月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东希荻微电子股份有限公司2021股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-011)。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为38人,行权股票数量为1,480,270股,自行权日起三年后可上市流通,预计上市流通时间为2025年3月16日。行权后,公司的股本总额由400,010,000股变更为401,490,270股。

2022年7月12日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东希荻微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动公告》(公告编号2022-046)。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的激励对象为38人,行权股票数量为3,044,935股,自行权日起三年后可上市流通,预计上市流通时间为2025年7月9日。行权后,公司的股本总额由401,490,270股变更为404,535,205股。

2022年9月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东希荻微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动公告》(公告编号2022-064)。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权的激励对象为18人,行权股票数量为771,809股,自行权日起三年后可上市流通,预计上市流通时间为2025年9月27日。行权后,公司的股本总额由404,535,205股变更为405,307,014股。

2023年2月11日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东希荻微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权结果暨股份变动公告》(公告编号2023-011)。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权的激励对象为19人,行权股票数量为1,720,843股,自行权日起三年后可上市流通,预计上市流通时间为2026年2月10日。行权后,公司的股本总额由405,307,014股变更为407,027,857股。

一七、修订公司章程并办理工商变更登记的情况

鉴于上述变更情况,为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司拟对《广东希荻微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修订,具体内容如下:

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 1 | 章程名称:广东希荻微电子股份有限公司章程 | 章程名称:希荻微电子集团股份有限公司章程 |
| 2 | 第一条为维护广东希荻微电子股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他有关规定,制订本章程。 | 第一条为维护希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他有关规定,制订本章程。 |
| 3 | 第四条公司注册名称:中文全称:广东希荻微电子股份有限公司<br>英文全称:Halo Microelectronics Co., Ltd.<br>公司住所:佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元<br>邮政编码:528200 | 第四条公司注册名称:中文全称:希荻微电子集团股份有限公司<br>英文全称:Halo Microelectronics Co., Ltd.<br>公司住所:佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元<br>邮政编码:528200 |
| 4 | 第五条公司注册资本为人民币40,001万元。 | 第五条公司注册资本为人民币40,702.7857万元。 |
| 5 | 第十七条公司的股份总数为40,001万股,每股面值人民币1.00元,均为普通股。公司设立时的发起人、认购的股份数、持股比例和出资方式的情况如下:……上述发起人分别以其占广东希荻微电子股份有限公司净资产的份额作为出资缴纳认缴股本。该认缴额已于2020年12月15日缴足。 | 第十七条公司的股份总数为40,702.7857万股,每股面值人民币1.00元,均为普通股。公司设立时的发起人、认购的股份数、持股比例和出资方式的情况如下:……上述发起人分别以其占广东希荻微电子集团股份有限公司净资产的份额作为出资缴纳认缴股本。该认缴额已于2020年12月15日缴足。 |
| 6 | 第七十四条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。<br>《广东希荻微电子股份有限公司股东大会议事规则》作为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。 | 第七十四条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。<br>《希荻微电子集团股份有限公司股东大会议事规则》作为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。 |
| 7 | 第一百一十六条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。《广东希荻微电子股份有限公司董事会议事规则》应规定董事会的召开和表决程序,并应作为本章程的附件,由董事会拟定,经股东大会批准。 | 第一百一十六条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。《希荻微电子集团股份有限公司董事会议事规则》应规定董事会的召开和表决程序,并应作为本章程的附件,由董事会拟定,经股东大会批准。 |
| 8 | 第二百一十五条本章程附件包括《广东希荻微电子股份有限公司股东大会议事规则》、《广东希荻微电子股份有限公司董事会议事规则》和《广东希荻微电子股份有限公司监事会议事规则》。 | 第二百一十五条本章程附件包括《希荻微电子集团股份有限公司股东大会议事规则》、《希荻微电子集团股份有限公司董事会议事规则》和《希荻微电子集团股份有限公司监事会议事规则》。 |

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。

一八、其他事项说明及风险提示

1. 本次变更公司名称是基于公司战略发展需要,公司主营业务、发展方向、实际控制人等均不发生变化,不会对公司生产经营活动产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2. 上述变更事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会,并由董事会进一步授权董事长或其进一步授权的人士代表公司就上述公司名称、注册资本及股本变更、《公司章程》修订等事宜办理相关工商登记、备案手续。

3. 上述变更事项完成后,公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等,一并进行相应修改、变更。

4. 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

广东希荻微电子股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2023-019

## 广东希荻微电子股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一九、董事会会议召开情况

广东希荻微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十六次会议于2023年4月7日以通讯方式和书面方式发出通知,并于2023年4月19日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人,实际参加会议表决的董事为9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东希荻微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二零、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2022年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

根据《上市公司治理准则